

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访</p> <p><input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会</p> <p><input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他： <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>【凯基证券股份有限公司】：杨哲汉，陈浩</p> <p>【华安证券股份有限公司】：汤宏伟</p> <p>【富邦证券投资信托股份有限公司】：张庭豪</p> <p>【深圳市富果投资管理有限公司】：付罗龙，吴寿康</p> <p>【深圳市尚珑基金管理有限公司】：沈俊红</p> <p>【深圳前海春秋投资管理有限公司】：邱志远</p> <p>【深圳市辰禾投资有限公司】：荆祖民</p> <p>【深圳市瀚鑫私募证券投资基金管理有限公司】：谢立堃</p> <p>【海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙)】：代俊攀</p> <p>【深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)】：周洁</p> <p>【上海恒穗资产管理中心(有限合伙)】：骆华森</p> <p>【华凯资产管理有限公司】：李准</p>

时间	2025 年 7 月 15 日 14:00-17:00
地点	公司会议室及电话会议
上市公司接待人员姓名	<p><b>【主讲人】：</b></p> <p>唐娅 财务总监、董事会秘书</p> <p>吴昊晟 董事会秘书助理</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：介绍公司基本情况</b></p> <p>公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，现有产品布局覆盖 DC/DC 芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片等，具备高效率、高精度、高可靠性的良好性能。</p> <p><b>第二部分：问答环节</b></p> <p>Q: 请问模拟芯片行业的市场空间预计有多大？</p> <p>A: Mordor Intelligence 研究数据显示，2024 年，全球模拟芯片市场将达到 912.6 亿美元，预计到 2029 年，市场规模将进一步增长至 1,296.90 亿美元。模拟芯片拥有广阔的市场空间，可以应用于消费电子、家用电器、汽车及工业等诸多下游领域。</p> <p>Q: 当前模拟芯片行业的国产替代程度如何？</p> <p>A: 在国家政策积极引导下，国产替代进程稳步推进。但目前工业、汽车及高端消费等领域，国产模拟芯片的整体替代率仍处于较低水平，国产化空间依然广阔。信达证券研究报告显示，受益于国家政策支持 and 国内厂商的技术突破，2024 年模拟芯片自给率预计增长至 16%，但仍然有较大的提升空间。</p>

Q: 请问公司汽车产品的导入进展如何?

A: 汽车产业链的特点为供应体系稳定, 前期导入周期长, 验证标准严苛。公司主要聚焦于车规级电源管理芯片领域, 致力于提供升压/降压 DC-DC 芯片、LDO 稳压器、高/低边驱动芯片以及摄像头 PMIC 等产品。截至目前, 公司车规级 DC/DC 芯片已进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计, 实现了向 Joynext、Yura Tech 等全球知名的汽车前装厂商出货, 并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外, 公司车规级 LDO 稳压芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货。公司将持续加快新产品的导入进程, 并加大市场拓展力度, 以推动汽车业务的发展。

Q: 请问公司汽车产品已经通过相关认证了吗?

A: 公司车规级芯片产品符合 AEC-Q100 标准, 且公司已通过 ISO 26262 汽车功能安全流程认证。

Q: 请问公司与高通和联发科的合作主要在哪些领域?

A: 公司较早进入了高通和联发科参考设计, 公司与高通的合作包括消费电子和汽车电子领域, 公司与联发科的合作主要聚焦在消费电子领域。

Q: 请问公司如何展望后续产品价格?

A: 公司产品价格受到产品定价政策、市场供需情况、行业竞争情况等多方面因素影响, 公司会不断推出具有竞争力的创新性产品, 以改善公司的综合毛利率情况。

Q: 请问公司成本端预计会有何变化?

	<p>A: 公司与国内外多家知名晶圆厂和封测厂建立了合作，会持续通过优化供应链管理体系来降低委外生产成本。目前，公司在供应链成本管理方面已经取得了一定成效。</p> <p>Q: 请问公司今年第二季度的订单情况如何？</p> <p>A: 第二季度公司客户需求较为旺盛，且第一季度部分订单因备货不足无法满足会在第二季度得到反应。</p> <p>Q: 请问公司中长期的规划是什么？</p> <p>A: 自 2012 年成立以来，希荻微一直秉持着“绿色能源，美好生活”的使命，形成以客户、产品、人才、创新、品牌为着力点的发展战略，致力于成为模拟芯片领域中细分赛道的国际领先企业，提供业界领先的模拟和电源管理芯片和方案，使能全球高能效智能系统应用。公司会紧密围绕下游客户需求以及行业发展趋势，不断拓宽产品的宽度和深度，坚持产品多元化的布局，力求搭建平台型公司。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 15 日